

# MT18SD-H

- ・ MicroThin は18 $\mu$ mのキャリア銅箔が付いている極薄銅箔です。  
MicroThin is ultra thin foil with 18 $\mu$ m carrier foil.
- ・ 微細回路形成に有効で、L/S=35/35~40/40の回路形成が可能です。  
Usable for fine pitch pattern L/S=35/35 - 40/40 formation.

## 用途/Application

- ・半導体パッケージ基板  
/Semiconductor Package
- ・多層プリント配線板  
/High Density Interconnect

## 構成/Composition



## 生産拠点/Production Site

- ・日本 / Japan
- ・マレーシア/Malaysia

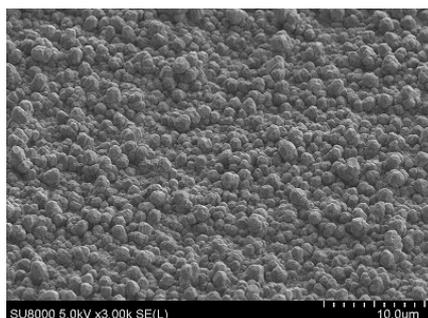
## 代表的特性値/Representive date

	$\mu$ m	Area weight (g/m <sup>2</sup> )	Laminate side Rz( $\mu$ m)	Tensile Strength (N/mm <sup>2</sup> )	Elogation (%)	Peel Strength (kg/cm)@FR-4
MT18SD-H	3	39	3	-	-	1.4
	5	57	3	-	-	1.4

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。  
This is representative date, not guarantee.

※Peel Strength は、35 $\mu$ mまでメッキアップした後の測定値  
Evaluated after plated up to 35 $\mu$ m

ラミ面/Laminate side



レジ面 resist side

